



Wytyczne w zakresie
instalacji płytek i
paneli winylowych
Intoo 55

Przechowywanie i transport

Pudełka należy przechowywać i transportować na płasko, ułożone w równych stosach i nigdy nie należy ustawiać ich pionowo. Pudełek nie należy przechowywać w miejscach bardzo zimnych (w temperaturze poniżej 2°C), bardzo ciepłych (w temperaturze powyżej 27°C) ani wilgotnych.

Przed instalacją

Kontrola wzrokowa

Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń, wad produkcyjnych i różnic przed jego zamontowaniem i przy odpowiednim świetle. Proszę sprawdzić, czy kolory i ilość produktu są zgodne z zamówieniem oraz czy na opakowaniach nie ma żadnych widocznych uszkodzeń. W trakcie instalacji należy sprawdzać, czy poszczególne panele Intoo 55 nie mają widocznych wad. Nie należy instalować paneli, na których widoczne są jakiegokolwiek niedoskonałości. Zalecamy, aby do każdej instalacji używać materiałów z jednej partii produkcyjnej, ponieważ nie możemy zagwarantować pełnego dopasowania odcieni produktów pochodzących z różnych partii. Należy pamiętać, że niektóre wzory różnią się w sposób naturalny. Zalecamy również, aby nie mieszać produkty z różnych opakowań.

W przypadku wad, które są widoczne przed instalacją, Moduleo® nie ponosi odpowiedzialności za koszty demontażu i wymiany. Instalacja oznacza akceptację wyrobu.

Zastosowanie

- Intoo 55 można układać na odpowiednio przygotowanych podłożach betonowych, z jastrychu cementowego, z jastrychu anhydrytowego (siarczan wapnia), na podłożach drewnianych i płytkach ceramicznych (patrz punkt „Przygotowanie podłoża”).

- Intoo 55 jest odpowiednim pokryciem podłogowym dla wszystkich typów podłóg podniesionych zgodnych z normą EN12825. Pokrycie podłogowe [method] jest odpowiednie do zastosowania na podniesionych podłogach technicznych zgodnych z normą EN12825. Z uwagi na to, że ten standard powstał z myślą o płytkach dywanowych, równość i płaskość takiego podłoża może nie pozwolić na osiągnięcie najlepszego możliwego wyglądu podłogi Intoo 55. Zwiększenie płaskości podłogi podniesionej ponad wymagania określone w normie poprawi jej estetykę. Przed montażem zalecamy uzgodnienie z wszystkimi zainteresowanymi stronami zakresu tolerancji.
- Intoo 55 można stosować na tradycyjnych wodnych systemach ogrzewania i chłodzenia podłogowego. Patrz rozdział dotyczący ogrzewania podłogowego. Temperatura powierzchni podkładu nie może przekraczać 27°C.
- Podłoga Intoo 55 jest odpowiednim wyłącznie do instalacji wewnątrz pomieszczeń.
- Sezonowe zmiany temperatury: Intoo 55 jest przeznaczona głównie do pomieszczeń biurowych, w przypadku których istnieje możliwość regulacji temperatury. W każdych warunkach należy utrzymywać temperaturę powietrza i wykładziny w zakresie od 15°C do 27°C. Należy unikać gwałtownego wzrostu temperatury o więcej niż 5°C w ciągu 12 godzin.
- W strefach, w których podłoga może osiągać ekstremalne wahania temperatur lub/i być intensywnie eksploatowana, czy obciążana, podłoga Intoo 55 musi być trwale przyklejona z zastosowaniem kleju o odpowiednim zakresie temperatur, lub odpowiedniego kleju dyspersyjnego, czy dwuskładnikowego kleju Epoxy/PU. (patrz poniżej)

Skład, konstrukcja i jakość podłoża

Informacje na temat składu i konstrukcji podłoża lub podkładu pozwalają na prawidłowe sprawdzenie dopuszczalnej wilgotności, płaskości, wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie podłoża. Ponadto informują o tym, jaki rodzaj przygotowania podłogi, masy wyrównującej/wygładzającej i ewentualnej bariery przeciwwilgociowej może być potrzebny podczas procesu instalacji. W przypadku niejasności lub wątpliwości co do jakości lub składu podłoża, należy sprawdzić lokalne normy instalacyjne i/lub zasięgnąć porady u producenta/dostawcy preparatu służącego do przygotowania podłoża, masy wyrównującej.



Przepisy i normy krajowe

Miejsce i warunki instalacji muszą być zawsze zgodne z odpowiednimi przepisami krajowymi i normami instalacyjnymi.

W przypadku, gdy norma lub przepis krajowy różni się od zaleceń producenta, znaczenie nadrzędne ma wymóg bardziej restrykcyjny.

W przypadku warunków montażu nieujętych w niniejszej instrukcji w celu uzyskania porady skontaktuj się z działem technicznym.

Przygotowanie podłoża

Nierówności podłoża

Dobre przygotowanie podłoża jest niezbędne w celu zapewnienia bezproblemowego montażu. Ponadto odpowiada za uzyskanie doskonałego wykończenia podłogi Intoo 55. Wygląd podłogi Intoo 55 zależy od jakości podłoża, na którym jest zainstalowana. Wszelkie nierówności podłoża będą widoczne na gotowej podłodze, podłoże należy zatem odpowiednio przygotować przed instalacją.

Podłoże musi być twarde, stabilne, płaskie, gładkie, czyste i suche, bez wad i uszkodzeń, musi nadawać się do określonego celu. W razie potrzeby należy zeszkrobać i usunąć resztki starego kleju oraz odspojonej masy wyrównującej. Należy upewnić się, czy na podłożu nie ma żadnych substancji chemicznych i innych zanieczyszczeń.

Ze względów estetycznych zalecamy by podłoże pod względem płaskości nie posiadało odchyień większych niż 2mm /2m i 0,2mm/20cm.

Aby przez powierzchnię wykończonej podłogi nie przebiły żadne nierówności, należy zastosować odpowiednią sklejkę/szpachlówkę wyrównującą. Wybór odpowiednich materiałów, w tym sklejki bądź masy wyrównującej, a także wszelkich produktów pomocniczych, uzależniony jest od przeznaczenia danej powierzchni i musi być uzgodniony z dostawcą tych materiałów oraz z instalatorem posadzki. Wszelkie materiały do przygotowania podłoża należy stosować zgodnie z zaleceniami ich producentów oraz krajowymi normami dotyczącymi elastycznych pokryw podłogowych.

Intoo 55 jest odpowiednia dla wszystkich typów podłóg podniesionych zgodnych z normą EN12825. Z uwagi na to, że ten standard powstał z myślą o płytkach dywanowych, równość i płaskość takiego podłoża może nie pozwolić na osiągnięcie najlepszego możliwego wyglądu podłogi Intoo 55. Zwiększenie płaskości podłogi podniesionej ponad wymagania określone w normie poprawi jej estetykę.

Przed montażem zalecamy uzgodnienie z wszystkimi zainteresowanymi stronami zakresu tolerancji, ponieważ rodzaj wzoru i wykończenia ma wpływ na estetykę. Zazwyczaj tolerancja nierówności podłoża jest większa w przypadku wzorów o zróżnicowanej kolorystyce, głębszej strukturze i wyraźnych fazowaniach krawędzi niż w przypadku wzorów z jednolitą kolorystyką, gładką strukturą i bez fazowanych krawędzi.

Wilgotność podłoża

- Zawartość wilgoci w podłożu musi być zgodna z lokalnymi/krajowymi standardami przyjętymi dla danego pokrycia podłogowego.
- Dla wylewki cementowej bez ogrzewania podłogowego <2,0% wg CM przy RH na poziomie 75%
- Dla wylewki cementowej z ogrzewaniem podłogowym <1,8% wg CM przy RH na poziomie 75%
- Dla wylewki anhydrytowej bez ogrzewania podłogowego <0,5% wg CM
- Dla wylewki anhydrytowej z ogrzewaniem podłogowym <0,3% wg CM

W przypadku znajdujących się bezpośrednio na gruncie podłoża betonowych lub kamiennych należy zastosować skuteczną izolację przeciwwilgociową (DPM) zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi instalacji elastycznych pokryw podłogowych. Podczas montażu izolacji na powierzchni podłoża oraz nakładania masy wyrównującej należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. Moduleo® udostępnia na życzenie listę zalecanych producentów i dostawców tych materiałów.



Uwaga

Montażu podłogi nie należy rozpoczynać zanim instalator nie oceni i nie zaakceptuje podłoża oraz warunków panujących w miejscu montażu. Dylatacje konstrukcyjne budynku muszą być przeniesione na pokrycie podłogowe [method] i wykończone odpowiednim profilem.

Aklimatyzacja

Intoo 55 należy aklimatyzować w miejscu instalacji lub w pomieszczeniu, w którym panują takie same warunki, przez co najmniej 24 godziny przed montażem lub do czasu, gdy produkt osiągnie temperaturę otoczenia: minimalna temperatura wynosi 18°C, a maksymalna 27°C.

- Paczki z panelami należy ułożyć w prostych stosach z dala od źródeł ogrzewania, klimatyzacji oraz okien o intensywnym nasłonecznieniu. Ma to na celu stopniową aklimatyzację produktu.

Temperatura przed instalacją

Intoo 55 należy instalować w temperaturze pomieszczenia od 18°C do 27°C i temperaturze podłoża powyżej 15°C.

Rozpoczęcie instalacji

Temperatura podczas i po instalacji

Stała temperatura zmieniająca się nie więcej niż 5°C na dobę, nie niższa niż 18°C dla powietrza i 15°C dla podłoża musi być utrzymywana 24h przed montażem i w trakcie montażu. Sprawdź także instrukcję dotyczącą kleju.

Ogrzewanie podłogowe

Intoo 55 można stosować na tradycyjnych wodnych systemach ogrzewania podłogowego (zgodnie z normą EN 1264 część 1 do 5). Nie zaleca się stosowania przewodowych systemów elektrycznych, chyba że system jest pokryty co najmniej 9 mm warstwą odpowiedniej masy wyrównującej. Należy unikać bezpośredniego kontaktu z elektrycznymi przewodowymi systemami grzewczymi. Temperatura styku nie może nigdy przekroczyć 27°C. W razie wątpliwości i pytań sprawdź osobną instrukcję FLOORHEATING dotyczącą montażu i użytkowania podłóg na systemach ogrzewania podłogowego.

System ogrzewania podłogowego musi być wyłączony przynajmniej 24h przed montażem podłogi [method].

Strefy osiągające różne temperatury (np. sterowane osobnymi kontrolerami, ale nie tylko) trzeba rozdzielić, a takie rozcięcie dylatacyjne musi być wykończone odpowiednim profilem.

Dopiero po 72 godzinach od montażu należy stopniowo zwiększać temperaturę ogrzewania podłogowego o 5°C dziennie, aż do osiągnięcia standardowej temperatury roboczej, przy czym maksymalna temperatura powierzchni wynosi 27°C.

Sprawdź określone przez producenta podłogi wymagania, które musi spełniać system ogrzewania podłogowego aby mógł być zastosowany w połączeniu z podłogą.

0

Chłodzenie podłogowe

Intoo 55 można również instalować na podłogowych systemach chłodzenia. Temperatura zasilania wody chłodzącej nie może jednak spadać poniżej temperatury punktu rosy. Temperaturę podłoża należy utrzymywać zawsze na poziomie co najmniej 3 stopnie wyższym niż punkt rosy. Temperatury poniżej punktu rosy powodują kondensację, która może prowadzić do uszkodzenia kleju i pokrycia podłogowego.

Wymagana szczelina dylatacyjna

Podłoga Intoo 55 jest przeznaczona głównie do pomieszczeń biurowych, w przypadku których istnieje możliwość regulacji temperatury. W każdych warunkach należy utrzymywać temperaturę powietrza i wykładziny w zakresie od 15°C do 27°C. Należy unikać gwałtownego wzrostu temperatury o więcej niż 5°C w ciągu 12 godzin. W przypadku takich stałych warunków otoczenia wystarczy zamontować Intoo 55 do samej ściany, ale luźno - bez napierania na ścianę (metoda A).

W strefach, w których podłoga może osiągać ekstremalne wahania temperatur lub/i być intensywnie eksploatowana, czy obciążana, podłoga [method] musi być trwale przyklejona z zastosowaniem kleju Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® o odpowiednim zakresie temperatur, lub odpowiedniego kleju dyspersyjnego, czy dwuskładnikowego kleju Epoxy/PU. (patrz poniżej). W takich przypadkach szczelina dylatacyjna nie jest wymagana (dla metody B).

W przypadku montażu na lepkim podkładzie FLEX PRO zastosuj się do części "rekomendowany podkład" (dla metody C).

Metody montażu

Intoo 55 można zasadniczo instalować w następujący sposób:

- Metoda A: Na pół-łuzno (semi-looselaid) na odpowiednim preparacie czepnym - tackifier (zalecana opcja).
- Metoda B: Przyklejenie (zupełne) do podłoża z zastosowaniem kleju Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® tolerującym wysokie temperatury, lub dwuskładnikowego kleju epoxy/PU.
- Metoda C: Przylepianie do pływającego, lepkiego podkładu Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro.

W przypadku innych sposobów montażu niewymienionych powyżej, należy zawsze zasięgnąć porady technicznej u Moduleo® producenta, lub lokalnego przedstawiciela.

Metoda A: Układanie w systemie pół-łuznym na preparacie typu tackifier (nieograniczony rozmiar powierzchni)

Deski/ płytki Intoo 55 są montowane bez naprężeń przylegając do siebie nawzajem i do ścian/listew. Cała powierzchnia musi być dobrze osadzona na odpowiednim preparacie czepnym (tackifier).

Rozprowadź odpowiednią ilość preparatu klejącego, odczekaj do momentu osiągnięcia początkowej siły wiązania. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w specyfikacji stosowanego preparatu.

Zalety stosowania preparatu typu Tackifier

Zastosowanie preparatu Tackifier zmniejszy podatność Intoo 55 na przemieszczanie w miejscach, w których występują ruchy na podłogach podwieszanych oraz zapewni większą odporność w pomieszczeniach, w których będą wykorzystywane meble na kółkach lub narażonych na duże obciążenia toczne.

Panele łatwe do zamontowania i usunięcia. Szybki montaż (również w otoczeniu będącym w ciągłym użytkowaniu).

Oszczędność czasu i pieniędzy.

Natychmiastowa dostępność

Możliwy łatwy dostęp do podłoża

Łatwy w naprawie

Łatwe do zdemontowania bez szkody dla podłoża

Uwaga:

Po zdjęciu pokrycia podłogowego jego spodnia strona może pozostawać lepka. W przypadku zamiaru ponownego montażu należy chronić panele przed kurzem, drobkami piasku itp. Jeśli to konieczne, można zastosować dodatkową warstwę preparatu czepnego (tej samej marki i typu) na istniejącej warstwie preparatu.

Metoda B: Przyklejenie na stałe przy użyciu zalecanego kleju dyspersyjnego Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® lub dwuskładnikowego kleju epoksydowo-poliuretanowego (nieograniczona powierzchnia w m²)

Deski/ płytki [method] są montowane bez naprężeń przylegając do siebie nawzajem i do ścian/listew.

Całą powierzchnię należy przykleić klejem, zgodnie z zaleceniami producenta. Mocowanie na klej zmniejszy podatność Intoo 55 na przemieszczanie w miejscach, w których występują ruchy na podłogach podwieszanych oraz w których występują wahania temperatury i wilgotności oraz zapewni większą odporność w pomieszczeniach, w których będą wykorzystywane meble na kółkach lub narażonych na duże obciążenia toczne.

Zalety stosowania kleju permanentnego

Klej Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT:
Odpowiednie do większości powierzchni, stref intensywnego użytkowania i o niewielkich wahaniami temperatury.

Idealny w przypadku łączenia z innymi (mniej krytycznymi) obszarami, instalowanymi z wykorzystaniem środka adhezyjnego typu Tackifier.

Klej dwuskładnikowy: Odpowiedni do miejsc okresowo mokrych (wejścia) i miejsc o dużych wahaniami temperatury, np. nieogrzewane ogrody zimowe, przed dużymi oknami.

Zalecane kleje

Zdecydowanie rekomendujemy zastosowanie odpowiedniego kleju z wysokim zakresem temperatur. Zalecenia dotyczące kleju mogą się różnić w zależności od kraju lub kontynentu ze względu na skład klejów oferowanych w danym kraju, lokalne warunki klimatyczne oraz krajowe przepisy/normy dotyczące instalacji.

W przypadku wyjątkowych warunków otoczenia, które wymagają zastosowania specjalnego kleju, należy skontaktować się z działem obsługi technicznej Moduleo®.

Zalecane podkłady

Metoda C: Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®
Podkład FlexPro

Mimo iż Intoo 55 jest zazwyczaj rozwiązaniem przyklejanym (np. za pomocą kleju lub tackifiera) bezpośrednio na podłoże, możliwy jest również montaż z wykorzystaniem odpowiedniego podkładu.

Zawsze należy używać podkładu, który został przetestowany i zatwierdzony przez Moduleo® do stosowania z danym pokryciem podłogowym. Moduleo® nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności w przypadku stosowania niezatwierdzonych produktów.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Folia antyadhezyjna oraz wrażliwa na nacisk folia samoprzylepna dla szybkiego i łatwego montażu.
- Nadaje się do stosowania na systemach ogrzewania i chłodzenia podłogowego
- Zapewnia doskonałą stabilność wymiarową
- Rozwiązanie odpowiednie do stosowania w pomieszczeniach, w których będą wykorzystywane krzesła na kółkach lub narażonych na duże obciążenia toczne do 250 kg.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro wygładza niewielkie nierówności podłoża o maksymalnej szerokości 3 mm. Umożliwia montaż nowej podłogi na wcześniej położonych wykładzinach podłogowych, takich jak linoleum, homogeniczne wykładziny PCV i drewniane panele podłogowe lub płytki ceramiczne (bez konieczności wypełniania szczelin) dzięki minimalizacji lub całkowitemu wyeliminowaniu nierówności podłoża. Dla montażu na płytkach ceramicznych, pomiędzy którymi szerokość rowków przekracza 3mm, można użyć Moduleo FloorPrep do wypełnienia/wyrównania spoin pomiędzy płytkami.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro nadaje się do instalacji wyłącznie na podłogach, których temperatura powierzchni podczas instalacji wynosi co najmniej 18°C. Niezwykle ważne jest, aby w trakcie trwania całego procesu instalacji warunki montażu były nieustannie monitorowane oraz dokumentowane. Warto zachować sporządzoną w ten sposób dokumentację na wypadek konieczności weryfikacji warunków procesu instalacji.

Rozwiązanie Intoo 55 instalowane na podkładzie Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro tworzy tak zwaną podłogę „pływającą”. W stabilnych warunkach temperaturowych preferowaną metodą instalacji jest montaż bez naprężeń (=1 do 2 mm szczelina dylatacyjna na obwodzie pomieszczenia/obszaru, na którym montowana jest podłoga). Inteligentne rozwiązania pozwalające na zakrycie szczeliny dylatacyjnej znaleźć można w dziale „Wykończenie podłogi”.



Montaż podkładu Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro do układania w systemie luźnym

Arkusze podkładu należy układać w taki sposób, aby ich krawędzie przylegały do siebie w kierunku przeciwnym do kierunku układania nowego pokrycia podłogowego. Podkłady Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® należy układać stroną zadrukowaną do góry (jeśli dotyczy). Nie ma potrzeby łączenia (np. za pomocą kleju) pojedynczych arkuszy podkładu. Po odpowiednim ułożeniu podkładu należy rozpocząć montaż nowej podłogi zgodnie z instrukcją.

Każdy położony panel/płytkę należy natychmiast docisnąć za pomocą walca dociskowego (min. 50

kg). W czasie wiązania kleju wałkować kilka razy, w różnych kierunkach.

Nie stosować kleju bez uprzedniej konsultacji z działem technicznymi Moduleo®.

Gwarancja: Nasza gwarancja na podłogę z zastosowaniem dodatkowego podkładu obejmuje użycie wyłącznie dedykowanego przez nas podkładu pod LVT.

Montaż krok po kroku:

Zalecane narzędzia

- Taśma pomiarowa
- Ołówek
- Sznur traserski/laser do wyznaczania linii prostej
- Środek gruntujący lub klej oraz odpowiedni aplikator (Metoda A + B): wałek malarski oraz odpowiednia szpachelka do kleju (niewymagane w przypadku podkładu samoprzylepnego)
- Wilgotna ściereczka do usunięcia resztek kleju (nie dotyczy w przypadku podkładu samoprzylepnego)
- Przykładnica kątowa
- Nożyk
- Walec dociskowy – minimum 50 kg (lub ręczny wałek dociskający do małych powierzchni, niedostępnych dla dużego walca dociskowego) (wymagany tylko przy montażu z wykorzystaniem kleju)



Zalecenia ogólne

Należy określić metodę montażu na w oparciu o treść rozdziału „Metody montażu” powyżej.

Krok 1: Określić kierunek montażu podłogi. Obliczyć ilość potrzebnych paneli lub płytek (zgodnie z wymiarami pomieszczenia/obszaru, na którym będzie układana podłoga) i zaznaczyć na podłodze linię prostą za pomocą sznura traserskiego/lasera; linię prostą wyznacza się zazwyczaj równoległe z najdłuższą prostą ścianą.

W przypadku instalacji przy użyciu kleju (metoda A/B), przejść od razu do punktu 2.

Dla montażu na Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® podkładzie do looselay, zapoznaj się z rozdziałem powyżej mówiącym o montażu na podkładzie do looselay. + krok 7.

Krok 2: Wyznacz drugą linię tworząc sekcję (np. o szerokości 5 rzędów) do przyklejenia na Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® kleju o zakresie obejmującym wysokie temperatury (chyba, że montaż odbywa się na tzw. rzepie czepnym - tackifierze i cała powierzchnia da się zamontować na raz). Przed zastosowaniem kleju zapoznaj się z jego instrukcją.

Krok 3: Rozprowadzić równomiernie odpowiednią ilość kleju na podłożu respektując ewentualny czas odparowania wstępnego i czas otwarty (w zależności od zastosowanego produktu). Więcej informacji na ten temat znaleźć można w specyfikacji stosowanego kleju.

Krok 4: Ułożyć panele lub płytki, zwracając uwagę na kierunek strzałek zamieszczonych na spodniej stronie panelu/płytki, na zagruntowanej powierzchni pokrytej klejem. Rozpocząć układanie drugiego/kolejnego rzędu; w tym celu można użyć nowych paneli/płytek lub kawałków pozostałych po montażu poprzedniego rzędu. W celu zapewnienia najwyższych walorów estetycznych podłogi, nie zaleca się rozpoczynania kolejnego rzędu kawałkiem pozostałym z poprzedniego rzędu w celu uniknięcia tzw. „efektu schodków”. Warto również zwrócić szczególną uwagę, czy łączenia krótkich boków paneli w kolejnych rzędach nie leżą w jednej linii.

Usunąć rozpórki; przyciąć panele lub płytki, które znajdować będą się bezpośrednio przy ścianie lub listwie przypodłogowej.

Nie rozprowadzaj kleju na obszarze większym niż jesteś w stanie zamontować w czasie, w którym klej zachowa odpowiednie właściwości umożliwiające skuteczne klejenie (za wyjątkiem użycia tackifier'a na powierzchni możliwej do zamontowania w jeden dzień w jednym etapie).

Krok 5: Aby klej/środek przyczepny mógł zadziałać prawidłowo na całej długości panelu/płytki, element należy natychmiast docisnąć na całej długości za pomocą odpowiednich narzędzi (ręczny wałek dociskający).

Krok 6: Nadmiar kleju wytrzeć za pomocą wilgotnej ściereczki.

Krok 7: Każdy położony panel/płytkę należy natychmiast docisnąć za pomocą walca dociskowego (min. 50 kg). W czasie wiązania kleju wałkować kilka razy, w różnych kierunkach.

Powtórzyć kroki od 2 do 7 aż do zakończenia procesu montażu.

Wykończenie podłogi

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® zapewnia szereg inteligentnych rozwiązań podłogowych dostosowanych do Twoich potrzeb w zakresie wykończenia. Oferta łączy w sobie unikalną funkcjonalność i styl: wytrzymałe rozwiązanie, które zapewnia płynne przejścia pomiędzy łączonymi materiałami i powierzchniami.

Jak zakryć szczelinę dylatacyjną przy ścianie

Listwy przypodłogowe do malowania Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® – dostosowane do potrzeb

- Unikalny wodoodporny materiał
-



Profil końcowy Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®

- Zgrabny profil aluminiowy - minimalistyczny design, który nadaje elegancki i nowoczesny wygląd



Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® patrz www.moduleo.com

Konserwacja podłogi

Patrz osobna instrukcja dotycząca pielęgnacji i utrzymania.

Ważna część gwarancji:

- Prawie wszystkie podłogi będą z czasem zmieniać kolor pod wpływem promieniowania UV. Należy tego unikać, stosując zasłony lub filtry przeciwsłoneczne, gdy słońce świeci wyjątkowo mocno. PCV ma również tendencję do żółknięcia w zaciemnionych pomieszczeniach. W wyniku połączenia tych czynników zakryte fragmenty podłogi (pod meblami, pod stale zamkniętymi drzwiami itp.) mogą mieć inne zabarwienie niż pozostały obszar. Jest to cecha charakterystyczna dla wszystkich paneli i wykładzin z PVC, dlatego nie jest objęta gwarancją.
- Należy unikać stosowania gumowych lub lateksowych mat. Nie wolno również stosować kółek lub podkładek ochronnych z gumy i lateksu pod meblami (zalecamy stosowanie kółek typu „W” zgodnie z normą EN 12529).
- W przypadku układania w systemie luźnym Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Looselay, uszkodzenia podłogi winylowej spowodowane dużym przeciężeniem, obciążeniem tocznym lub przesuwaniem przedmiotów nie są objęte gwarancją.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu papierosów, zapalek i innych rozgrzanych przedmiotów z podłogą, ponieważ powoduje to trwałe uszkodzenia.
- Uwaga: Czyszczenie lub konserwacja może mieć miejsce wyłącznie jeżeli podłogi zostały zamontowane prawidłowo i nie ma widocznych niedoskonałości.
- W celu uzyskania informacji na temat warunków gwarancji należy skontaktować się z przedstawicielem lub sprzedawcą detalicznym.
- Niniejszy dokument został wydany w dniu (patrz: ostatnia strona niniejszego dokumentu) i zastępuje wszystkie poprzednie wersje; opublikowanie nowszej wersji dokumentu jest równoznaczne z zastąpieniem bieżącej edycji. Najnowszą wersję dokumentu znaleźć można na www.moduleo.com. Anglojęzyczna wersja dokumentu uznawana jest za oryginał.
- W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą instrukcją montażu a mającymi zastosowanie lokalnymi normami technicznymi/przepisami prawa, należy stosować się do bardziej rygorystycznych wymogów.

